

【Causes/processes involved/keys to judgment】

A clad copper teared by electrostatic destruction is transferred onto another copper conductor in reversed way to cause the defect (After pattern formation - before solder resist printing)

7-4-21 コンデンサ漏液による導体銅溶解／电容器漏液引起导线铜的溶解 / Dissolved copper conductor by leaked electrolyte of capacitor

【特徴】 コンデンサ端子下のスルーホール周りの導体銅が溶解している状態の欠陥

【特征】 电容器插脚下面的通孔周围的导线铜被溶解的缺陷。

【Characteristics】 Copper conductor is dissolved around a PTH under a capacitor terminal.

【原因・判断ポイント・発生工程】 実使用状態でコンデンサから漏れた含浸液により、導体銅が溶解されて出来たもの（実使用段階）

【原因、判断要点、发生工序】 在实际使用阶段，从电容器漏出来的液体溶解了导线铜而引起的（实际使用阶段）。

【Causes/processes involved/keys to judgment】

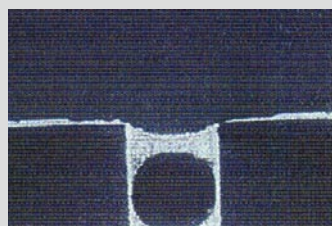
Electrolyte leaked from a capacitor while in use dissolves copper conductor, causing the defect (In field use)



【コメント】
コンデンサの下面が変色している
顕微鏡倍率 ×

【注釋】
左电容器下面变色
显微镜倍率 ×

【Comments】
Discolouration under capacitor
Magnification: ×



【コメント】
コンデンサリード端子
周りの導体銅が侵食さ
れている
顕微鏡倍率 ×

【注釋】
电容插脚周围的导线铜
被腐蚀
显微镜倍率 ×

【Comments】
Etched copper
conductor around
capacitor terminal
Magnification: ×

7-4-22 穴傷／孔伤 / Board damage making a hole

【特徴】 ベタ導体部に、基板樹脂部にまで食い込んだ窪み状の傷が見られる状態の欠陥。導体銅も露出している。

【特征】 在大铜面上有伤及树脂层并凹陷的缺陷，且露出导线铜。

【Characteristics】 A tear of conductor is observed in a wide conductive area reaching to base material. Copper conductor is exposed.

【原因・判断ポイント・発生工程】 先の尖った硬いものが板面に突き刺さって出来たもの（S R印刷後）



【コメント】
顕微鏡倍率 ×

【注釋】
显微镜倍率 ×

【Comments】
Magnification: ×